



产品特性 FEATURES

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| ◆ 硅平面工艺结构 | Planar technique |
| ◆ 双向负阻性保护 | Bidirectional crowbar protection |
| ◆ 低漏电流 | Low leakage current |

最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃)

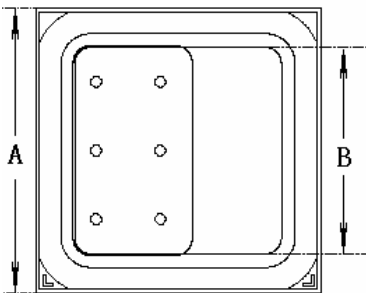
项目 Parameter	脉冲峰值电流 Repetitive peak pulse current	绝缘电阻 Insulation Resistance	工作结温 Operation Junction Temperature	存储温度 Storage Temperature
符号 Symbol	I _{PP}	R	T _J	T _{STG}
单位 Unit	A	Ω	℃	℃
额定值 Absolute Ratings	30(10/1000μs)	1000M	-40~150	-40~150

芯片电特性 CHIP ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tc=25℃)

参数 Parameter	测试条件 TestsConditions	最小值 Min.	典型值 Tye.	最大值 Max.	单位 Unit
不动作电压 V _{RM}	I _{RM} =2μA	6			V
最高限制电压 V _{BO}	100KV/s			25	V
通态电压 V _{TM}	I _T =1A			4	V
维持电流 I _H	10A, 10/1000μs		60		mA
极间电容 C	2V, 1MHz			60	pF

芯片信息 CHIP INFORMATION

圆片尺寸 Wafer Size	Φ4inch（100mm）	
芯片厚度 Chip Thickness	（215±15）μm	
芯片尺寸 Chip Size	A: 1.30mm×1.30mm	
金属 Metal	正面 Front	银 Ag
	背面 Back	银 Ag
键合区面积 Bond Area	B: 0.96mm×0.96mm	



The diagram shows a square chip package with a central square area containing six small circles arranged in a 2x3 grid. The overall width is labeled 'A' and the overall height is labeled 'B'. The package has a multi-layered border and rounded corners. Small squares in the corners indicate mounting or bonding points.

附录 (Appendix) : 修订记录 (Revision History)

日期 Date	旧版本 Last Rev.	新版本 New Rev.	修订内容 Description of Changes
2009-7-15		200907A	
2009-11-3	200907A	200910B	电话传真号码升位

